



# 2012年證券櫃檯買賣中心 業績發表會

Oct 30, 2012

# 公司概況(總部)

- 1999年10月成立
- 2005年1月上櫃(代號: 3264)  
2012年9月30日市值: 新台幣93億元
- 公司地點: 新竹工業區

開源廠:

總樓層面積: 259,000 ft<sup>2</sup>

無塵室面積: 81,600 ft<sup>2</sup>

鼎興廠:

總樓層面積: 210,000 ft<sup>2</sup>

無塵室面積: 102,000 ft<sup>2</sup>

高昇廠:

總樓層面積: 113,500 ft<sup>2</sup>

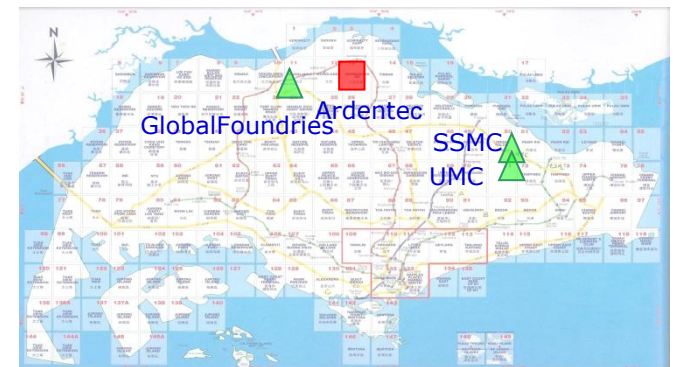
無塵室面積: 55,800 ft<sup>2</sup>

- 通過ISO9001、TS16949、ISO14001、ISO14064、ISO27001、OHSAS18001、QC080000、CG6005、AEO、ICP等認證。



# 新加坡子公司

- 2006年6月成立
  - 欣銓科技100%持有之子公司
- 實收資本額：星幣5,250萬元
- 公司地點：12 Woodlands Loop #02-00,  
Singapore 738283
  - 總樓層面積：81,500 ft<sup>2</sup>
  - 無塵室面積：41,077 ft<sup>2</sup>
- 通過ISO9001、TS16949、ISO14001、  
ISO27001 & OHSAS18001、STS Tier-3、  
Trade FIRST and ACMT Scheme等認證。



# 韓國子公司

- 2010年12月成立
  - 欣銓科技100%持有之子公司
- 實收資本額：274.8億韓元
- 公司地點：893-4 Eoyeon-ri,  
Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek City,  
Gyeonggi Province, Republic of Korea
  - 總樓層面積：106,000 ft<sup>2</sup>
  - 無塵室面積：36,600 ft<sup>2</sup>
- ISO9001 and bonded factory status  
認證。



# 系統封裝/裸晶測試技術的領先廠商

## 追求摩爾定律，系統封裝正是趨勢

- 在趨向高度整合、SiP測試需求、異質多功能整合的無線元件市場，KGD (Known-Good-Die) 測試的需求與重要性日益增加。
- KGD 測試是目前主要的解決方案，因為沒有其他方式可以滿足在SiP 形式下所有的測試需要。

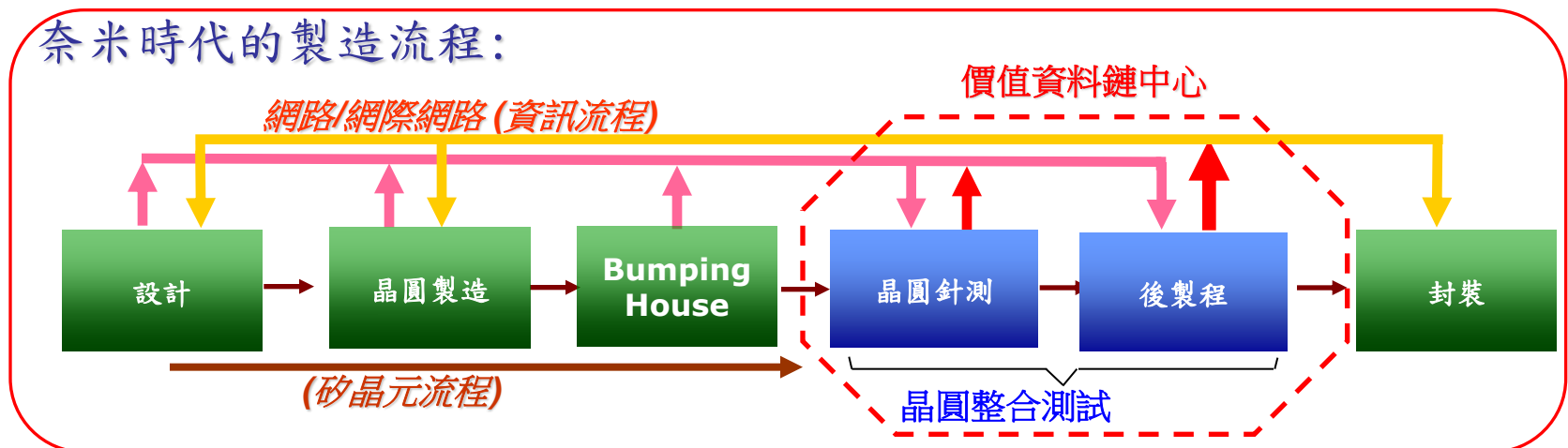
### 欣銓在KGD測試技術的貢獻

- 可靠性及品質篩選流程
  - 晶圓級預燒
  - 應用統計技術的品質篩選程序 (outlier process) 以及特定樣式異常的篩選
- 良率改善製程
  - 雷射修補
  - 類比信號微調
  - 註記編碼
- 高整合測試流程
  - 作業管制自動化IT系統
- 節省成本方案
  - 高並測數
- 高速測試
  - 可測試設計之結構測試
- 低功率及 & 行動性
  - 低溫及漏電流測試
- 晶圓製程線距微縮
  - 12吋晶圓針測
  - 鉑墊微距產品(Fine Pad Pitch)針測
  - 微距融絲(Fine Link Pitch)雷射修補
  - Low-k 銅製程鉑墊針測

# 在新興的價值鏈上扮演處理中心的角色

- 進入奈米時代，欣銓在後段流程中建立一個”後製程” (Post-Process)。
- 整合設計、製造、測試之所有數據，用以篩選 IC。
- 經由資訊高速公路，提供最廣泛的測試數據。
- 在有價值的數據鏈上扮演 “處理中心” 的角色。

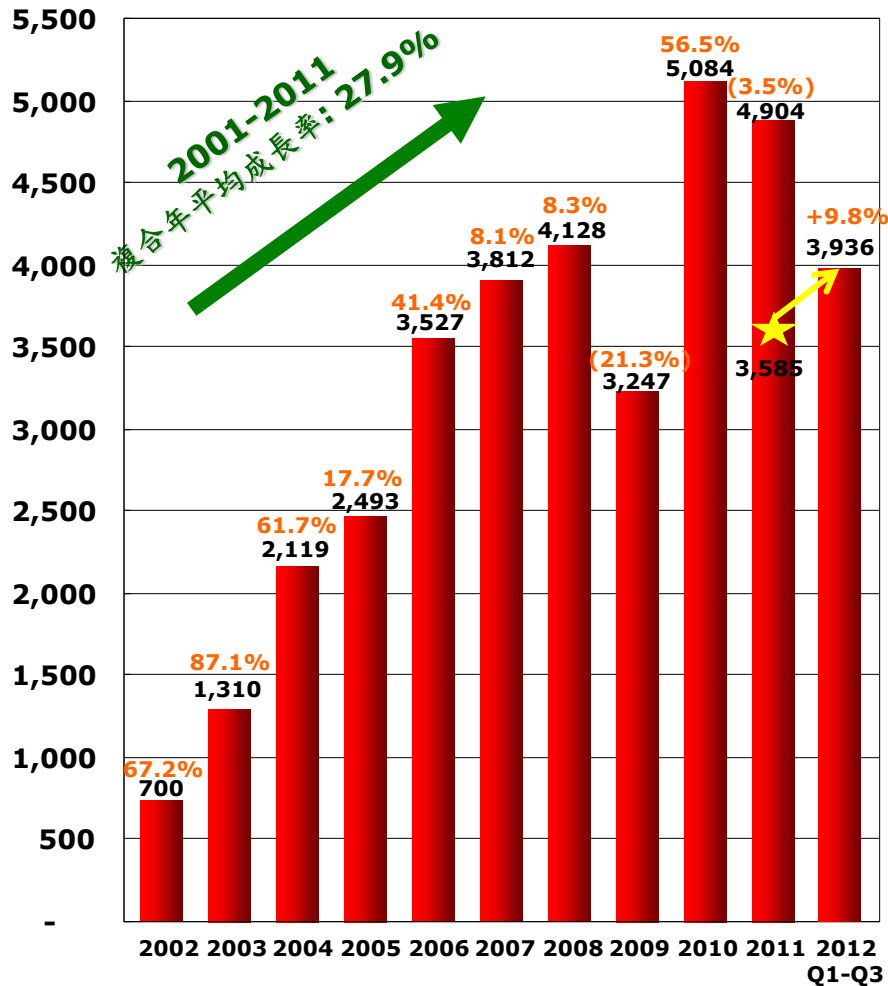
## 奈米時代的製造流程：



# 優於同業的營收成長

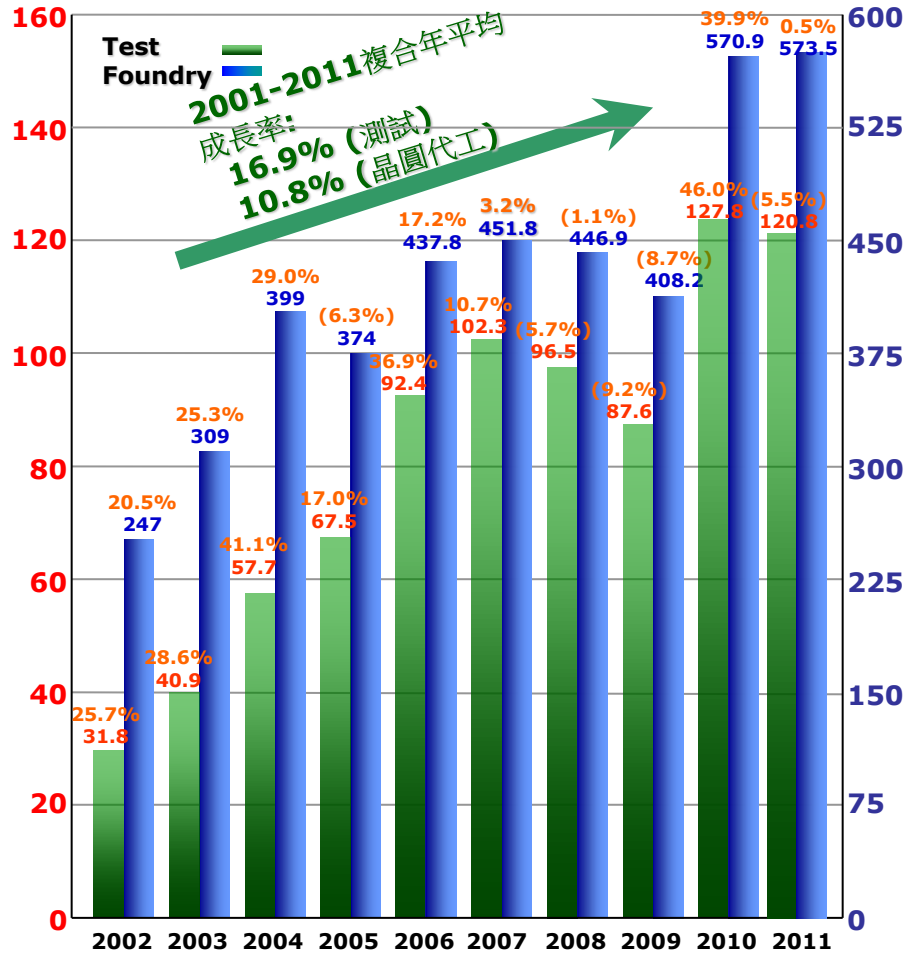
(in NT\$M)

欣銓



(in NT\$B)

台灣半導體產業



Source: IEK/ITIS Mar. 2012

# 良好的財務比率(總部單一財報)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012Q3
<b>流動性比率</b>											
流動比率	172%	173%	226%	177%	218%	201%	254%	291%	280%	228%	177%
速動比率	165%	168%	215%	167%	206%	195%	250%	285%	275%	219%	175%
<b>資產管理比率</b>											
固定資產週轉率	0.26	0.43	0.60	0.57	0.68	0.65	0.71	0.57	0.86	0.71	0.74
總資產週轉率	0.21	0.33	0.43	0.40	0.46	0.42	0.43	0.33	0.46	0.38	0.40
<b>負債管理比率</b>											
負債比率	51.0%	46.5%	31.3%	35.9%	29.6%	31.6%	27.0%	23.4%	27.9%	30.6%	30.58%
利息保障倍數	0.34	3.90	10.08	14.30	19.19	15.96	17.81	13.63	47.67	23.95	18.86
<b>獲利性比率</b>											
毛利率	10.7%	33.1%	45.3%	40.9%	42.2%	39.0%	39.9%	23.0%	39.5%	32.6%	32.58%
總資產報酬率	2.7%	11.4%	17.3%	13.7%	15.0%	12.3%	11.8%	4.81%	14.3%	7.4%	7.31%
股東權益報酬率	0.3%	17.6%	25.2%	19.3%	21.1%	16.6%	15.7%	5.96%	18.9%	10.5%	10.53%
每股盈餘(元)	0.03	1.37	2.45	2.40	2.76	2.41	2.39	0.94	3.18	1.87	1.40



# 2012/Q3 營運績效

(In NT-K\$ excepted otherwise noted)

	Q3'12	Q2'12	Q3'11	QoQ	YoY
淨營業收入	1,381,537	1,323,109	1,197,660	4.42%	15.35%
營業毛利	31.33%	30.98%	28.31%	1.2 pts	3.02 pts
營業費用	21.92%	22.34%	17.88%	-0.42 pts	4.04 pts
基本每股盈餘 (NT\$)	0.55	0.50	0.39	10.00%	41.03%
自由現金流量 (FCF)(*)	540,845	692,121	-751,056	-22%	172.01%
股東權益報酬率	10.53%	9.75%	10.59%	0.78 pts	-0.06 pts

(\*) Free Cash Flow = Cash from operating activities - Capital expenditures

# 2012/Q1~Q3營運績效

(In NT thousands excepted otherwise noted)

淨營業收入

**3,936,213**

**3,588,483**

**9.69%**

營業毛利

**29.12%**

**30.46%**

**-1.34 pts**

營業費用

**20.16%**

**20.89%**

**-0.73 pts**

基本每股盈餘 (NT\$)

**1.40**

**1.38**

**1.45%**

自由現金流量 (FCF)(\*)

**540,845**

**- 751,056**

**172.01%**

股東權益報酬率

**10.53%**

**10.59%**

**-0.06 pts**

(\*) Free Cash Flow = Cash from operating activities - Capital expenditures

# 連續8季營收表現



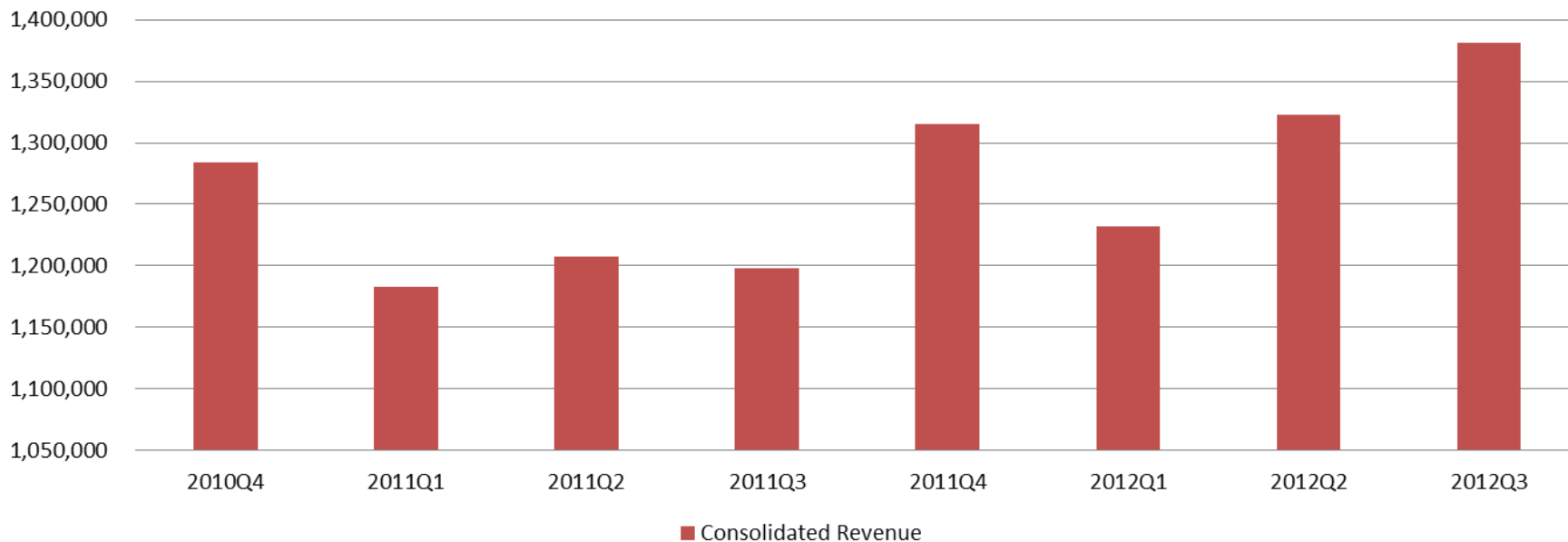
2010

2011

2012

(NT\$K)

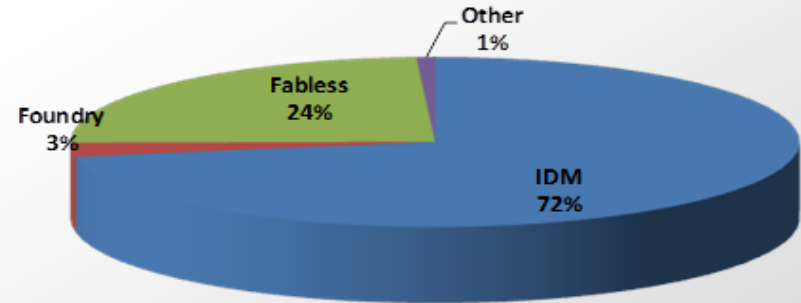
Quarter	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Revenue	1,283,943	1,183,207	1,207,616	1,197,660	1,315,345	1,231,567	1,323,109	1,381,537



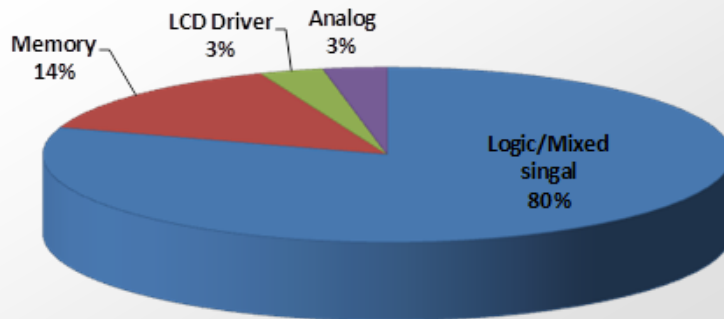
# 2012/Q3營收分類(合併)

2012年Q3合併總營收新台幣  
39.36億元

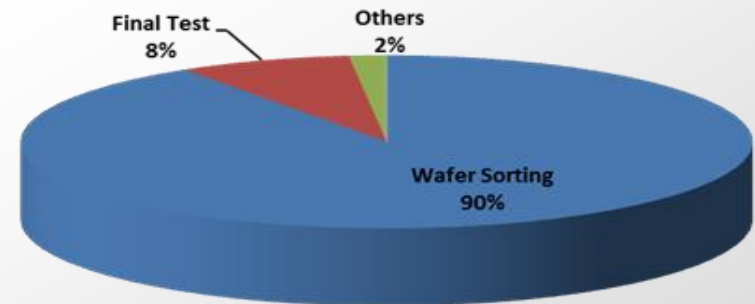
## 依客戶別分類:



## 依產品別分類:



## 依測試別分類:



# 大事紀

- 2011年10月榮獲歐洲通訊IC設計公司頒發優良協力廠商獎
- 2010年11月榮獲全國商業總會頒發之金商獎
- 2012年2月榮獲快閃記憶體大廠頒發2011年度最佳晶圓測試供應商獎，本次獲獎係連續第二年取得該獎項
- 2012年3月榮獲中國積體電路製造大廠頒發2011年度優良服務供應商獎，本次獲獎係連續第二年取得該獎項
- 2012年6月榮獲美國IDM公司頒發2011年度 供應商獎
- 2012年6月榮獲經濟部國貿局通過(Internal Control Program, ICP)企業內部管控制度優良廠商
- 2012年7月與台灣銀行等共八家銀行團簽訂聯合授信合約，金額新台幣25億元整



**<http://www.ardentec.com>**  
**[Investors@ardentec.com](mailto:Investors@ardentec.com)**